

IKO EAC PLUS

Description

Enduit d'application à chaud.

Utilisations principales

Collage des panneaux isolants.
Collage des pare-vapeurs bitumineux.

Composition

Bitume de distillation directe restructuré.

Recommandation

La fonte des pains d'IKO EAC PLUS est préconisée en fondeur régulé en température.

Caractéristiques

Point de ramollissement Bille et Anneau (°C) (NF EN 1427)	90 - 120
Pénétrabilité à 25°C (1/10 mm) (NF EN 1426)	20 - 45
Densité relative à 25°C (Kg/m ³) (NF EN ISO 3838)	1000 - 1100
Point d'éclair (méthode Cleveland à vase ouvert) (C°) (NF EN ISO 2592)	≥ 250
Température d'utilisation recommandée (°C)	160 ± 10

Conditionnement

Pain filmé (kg)	17
Nombre de pains par palette (unité)	53

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.